

第一章 集成电路器件基础

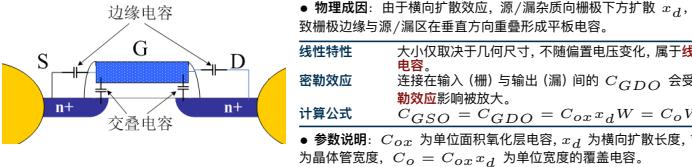
MOS 管寄生效应 (主要是 MOS 器件电容模型)

● 主要耦合电容：任意两端子间均存在电容耦合：

C_{GS}, C_{GD} 横-源 / 横-漏电容
 C_{GB} 横-衬底电容
 C_{SB}, C_{DB} 源-衬底 / 漏-衬底电容



● 定义：栅极与源/漏扩散区重叠部分形成的电容，称为覆盖寄生电容。



PN 结电容 ● 定义：即源/漏区与衬底间的电容 (C_{SB}, C_{DB})，由反偏 PN 结的势垒电容（耗尽电容）构成。



栅沟道电容（本征电容） 由于不同工作区的沟道形态不同，栅沟道电容也不同：



阈值电压 (这部分看半导体器件物理 cheat sheet 观感更佳)

● 定义： V_T 是表面载流子浓度等于衬底掺杂浓度（强反型）时的 V_{GS} 。此时表面电势 ϕ_s 达到 $2\phi_F$ 。

函数关系 ϕ_{ms} 抵消金属与半导体费米能级不匹配，由材料本征属性决定。

耗尽电荷 Q_B 补偿耗尽固定电荷。NMOS 中 $Q_B < 0$ ，对应项 $-\frac{Q_B}{C_{ox}}$ 为正。

强反型电势 $2\phi_F$ 产生强反型所需的能带弯曲量。P 极区 $\phi_F < 0$ ，项 $-2\phi_F$ 为正。

表面电荷 Q_{SS} 氧化界面正电荷，有助于感应电子，从而降低 V_T 。项 $-\frac{Q_{SS}}{C_{ox}}$ 为负。

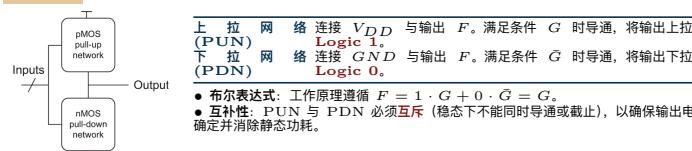
注入电荷 Q_I 工艺调节项，通过离子注入（如 P+注入）精确修正 V_T 数值。

$$\text{● 汇总公式: } V_T = \phi_{ms} - 2\phi_F - \frac{Q_B}{C_{ox}} - \frac{Q_{SS}}{C_{ox}} - \frac{Q_I}{C_{ox}}$$

● 物理本质： V_T 是克服材料差异、抵消干扰电荷、平衡耗尽层并建立强反型表面电势所需的栅极电压总和。

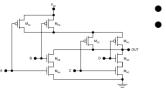
速度饱和 这个暂时没在 PPT 上找到，先空着吧。

互补网络 ● 架构组成：由两个相互关联的网络组成：



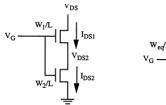
习题解析

课堂练习 主要是一些判断逻辑以及跟器件强相关的题目，和模电很像。



- 例题 1：考虑图中的静态互补 CMOS 逻辑门，写出它的布尔表达式（注意化简）。
- 启发意义：没啥启发意义。

- 答解：这道题看下网络比较好判断逻辑，答案是 $F = AB + CD$ 。



- 例题 2：计算两个宽长比分别为 W_1/L 和 W_2/L 的串联 NMOS 晶体管的等效宽长比 W/L 。忽略体效应，阈值电压恒定。
- 启发意义：单看题目只是一个模集的题，但是为后面计算串联尺寸系数打下基础。

- 答解：● 推导前提：利用线性区电流公式 $I_{DS} = k' \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_{T0})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$ ，基于电流连续性 ($I_{DS1} = I_{DS2}$) 进行推导。

$$\text{M2 (下管)} \quad I_{DS} = k' \frac{W_2}{L} [(V_{GS} - V_{T0})V_{DS2} - \frac{1}{2}V_{DS2}^2]$$

$$\text{M1 (上管)} \quad I_{DS} = k' \frac{W_1}{L} [(V_{GS} - V_{DS2} - V_{T0})(V_{DS} - V_{DS2}) - \frac{1}{2}(V_{DS} - V_{DS2})^2]$$

- 代数变换：展开 M1 方程并提取项，可发现其包含 M2 的电压项。整理得： $I_{DS} = k' \frac{W_1}{L} [((V_{GS} - V_{T0})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2) - \frac{I_{DS}}{k'(W_2/L)}]$ 。

- 等效结果：将 I_{DS} 项移项合并，对比标准方程可得： $\frac{1}{Weq} = \frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}$ 或 $Weq = \frac{W_1 W_2}{W_1 + W_2}$ 。

● 物理意义与设计指导：

电容类比 导通电阻 $R_{on} \propto L/W$ ，串联电阻 $R_{eq} = R_1 + R_2$ 对应 $\frac{L}{Weq} = \frac{L}{W_1} + \frac{L}{W_2}$ 。
 尺寸补偿 串联会降低驱动能力。若要使两个串联管等效于宽度为 W 的单管，则每个管子宽度需设为 $2W$ 。

作业题 有一些奇奇怪怪的题，不知道牢王都从哪找的。

- 例题 1-1：(1) 考虑下图的静态互补 CMOS 逻辑门，写出布尔表达式（注意化简），并画出下拉网络结构；(2) 画出实现 $Y = AB + C(D+E)$ 的静态互补 CMOS 逻辑门电路的晶体管级电路图。
- 启发意义：这道题的上拉电路给的很怪，没有办法直接看出逻辑表达式，需要通过分析通路来推导。

- 第一步：寻找从 V_{DD} 到 Output 所有可能通路 (PMOS 导通需低电平)：

直接路径 $A \bar{C}$; 路径 2: $B \bar{D}$
 跨桥路径 路径 3: $A \bar{E} \bar{D}$; 路径 4: $B E \bar{C}$
 PUN 逻辑 $F = \bar{A} \bar{C} + \bar{B} \bar{D} + A \bar{E} \bar{D} + B E \bar{C}$

- 第二步：推导下拉网络 (PDN) 的导通条件：

设计原理 CMOS 逻辑具有反相特性。PDN 由 NMOS 构成（高电平导通），需满足输出为低电平 (Logic 0) 的条件。即求 \bar{Out} 。

德摩根变换 对 PUN 表达式整体取反： $\bar{Out} = (\bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{E}\bar{D} + \bar{B}E\bar{C})$
 逻辑展开 得 $\bar{Out} = (\bar{A}\bar{C}) \cdot (\bar{A}\bar{E}\bar{D}) \cdot (\bar{B}\bar{D}) \cdot (\bar{B}E\bar{C})$
 去反号 根据 $\bar{X}Y = X\bar{Y}$ ，得 $\bar{Out} = (A+C)(A+E+D)(B+D)(B+E+C)$

- 代数化简：通过提取公因式进行重组织：

分组观察 前两项含 A，后两项含 B，利用分配律： $(A+C)(A+E+D) = A + C(E+D)$

最终嵌套形式 $\bar{Out} = AB + AED + CD + BEC$

电路对应 该表达式直接决定了 PDN 的串并联拓扑结构。

- 例题 1-2：请分别解释说明体效应、短沟效应、DIBL 对阈值电压影响及原理。

- 启发意义：一些牢王自己忘记讲的概念

- 解析：

体效应

当 $V_{SB} > 0$ 时，更多负电荷聚集在栅氧化层下，增加了耗尽层电荷，导致 V_T 增加。公式： $V_T = V_{T0} + \gamma(\sqrt{V_{SB}} + |2\phi_F| - \sqrt{|2\phi_F|})$ 。源端势垒上升，需更大栅压克服势垒。

短沟道效应 当 L 减小时， V_T 随之减小。部分栅下区域空穴被漏-衬底 PN 结电场耗尽，导致 Q_B 下降；同时 MOS 效应影响区域比例变小，导致 V_{T0} 下降。

DIBL 效应 漏端感应势垒降低。 V_{DS} 增加使漏端耗尽区扩大并接近源端，引起源端势垒降低，使源区注入电子增加，导致 V_T 下降。

- 例题 1-3：请分别解释说明速度饱和对短沟器件和长沟器件的影响及原理。

- 启发意义：算是弥补上文缺失的速度补偿部分，牢王应该是又忘记了。

- 解析：● 载流子速度：速度 v 与电场 E 的关系近似为： $v = \frac{\mu_n E}{1 + E/E_c}$ 。

临界电场 E_c 速度饱和发生时的电场。连续性要求：当 $E = E_c$ 时， $v_{sat} = \mu_n E_c / 2$ 。
 短沟道修正 由于 L 极小，水平电场大，很快达到饱和。修正公式： $I_D = k' [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2] \kappa(V_{DS})$ ，其中 $\kappa(V) = \frac{1}{1 + V/(E_c L)} < 1$ 。

- 饱和电压 V_{DSAT} ：由连续性要求解得： $V_{DSAT} = \kappa(V_{GT})V_{GT}$ 。

物理结论

因为 $\kappa(V_{GT}) < 1$ ，所以 $V_{DSAT} < V_{GT}$ 。短沟道器件速度饱和的 V_{DSAT} 小于长沟道沟道夹断的 V_{DSAT} 。

当 $E_c \gg V_{GT}/L$ 时， $I_{DSAT} = \frac{1}{L} \frac{W}{C_{ox}} \mu_n V_{GT}^2$ ，电流电压为二次关系。
 当 $E_c \ll V_{GT}/L$ 时， $I_{DSAT} = v_{sat} C_{ox} W V_{GT}$ ，电流电压为一次关系。

- 作业 1-4：如图所示电路，已知 M1 参数如下（忽略体效应和沟道长度调制效应）：

电压参数 $V_{DD} = 2.5V$
 工艺常数 $k' = 115 \times 10^{-6} A/V^2$, $C_{ox} = 6fF/\mu m^2$
 覆盖电容 $C_{gso} = C_{gdo} = 0.31fF/\mu m^2$

- (1) 当 $V_{in} = 2.5V$ 时， V_{out} 的稳态电压（记为 V_{OL} ）是多少？M1 管处在什么工作区？

M1 工作在线性区，即满足 $V_{OL} < V_{DSAT} = 0.63V$ 。

- 1. 线性区电流公式： $I_{ds} = k' \frac{W}{L} [V_{in} - V_{T0}] V_{OL} - \frac{1}{2} V_{OL}^2$

2. 根据分压定律： $I_{ds} \cdot R + V_{OL} = V_{DD}$ (KVL)

$V_{DSAT} = V_{in} - V_{T0} = 2.07V$, $k' W/L = 460 \mu A/V^2$, $R = 8k\Omega$ 。

解得 $V_{OL} \approx 0.31V$ (另一解 $4.37V$ 舍去)。

因 $0.31V < 0.63V$ ，假设成立，M1 确实处于线性区。

- 解答 (2)：采用假设-验证法确定 V_{OL} 与工作区：

初始态 Q_1 $V_{in} = 0V$, $V_{out} = 2.5V$ (截止区)。

沟道未形成， C_{GCB} 无压差。 $C_{GCS} = 0$ ，且 GS 之间也没有压差， $C_{GCD} = 0$ ，但是 GD 之间存在电压 $Q_1 = C_{GD} \times (V_G - V_D) = C_{gdo} \times W \times (V_G - V_D) = (0.31 \times 1) \times (0 - 2.5) = -0.775fC$ (这里完全是 PN 结扩散电容)

$V_{in} = 2.5V$, $V_{out} = 0.31V$ (线性区)。沟道形成。

后面的计算留给读者自己完成，步骤就是：查看电容 → 看 GS、GD、GB 之间是否有电压 → 有电压有电容的地方计算电荷 → 累加。

总注入量 $\Delta Q = 4.97 - (-0.775) = 5.745fC$ 。

第二章 数字集成电路的速度

MOS 管电容模型

MOS 管的漏电流

逻辑门的静态特性

开关阈值（对称反相器）

CMOS 逻辑门的延时特性

本征延时、努力延时

逻辑努力（含义、计算）

关键路径的计算

逻辑路径的延时模型

尺寸优化问题

分支努力

第三章 数字集成电路的功耗

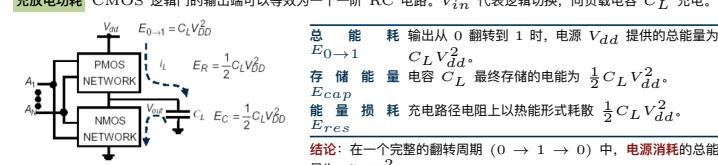
动态功耗 CMOS 功耗主要分为两大类：

动态功耗 电路逻辑状态翻转过程中产生的功耗，分为充放电功耗和短路功耗。
 静态功耗 电路处于稳态时，由漏电流引起的功耗。

动态功耗又可细分为：

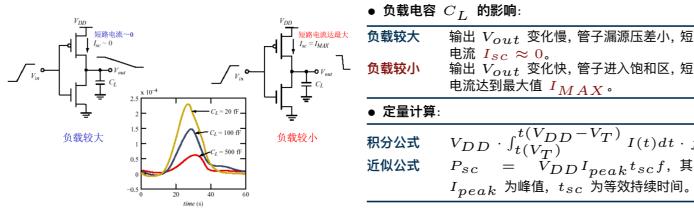
充放电功耗 对负载电容进行充电和放电所消耗的能量。
 短路功耗 输入/输出翻转瞬间 PMOS 和 NMOS 同时导通，形成 V_{dd} 到 GND 的瞬时通路。

充放电功耗 CMOS 逻辑门的输出端可以等效为一个一阶 RC 电路。 V_{in} 代表逻辑切换，向负载电容 C_L 充电。



充电 (0 → 1) PMOS 导通，电源提供能量。一半存于电容，一半消耗在 PMOS 网络电阻上。
 放电 (1 → 0) NMOS 导通，电源不能供能。电容储能耗于 NMOS 网络电阻上消耗。

短路功耗 ● 定义：输入/输出翻转瞬间，当 $V_{Tn} < V_{in} < V_{DD} - |V_{Tp}|$ 时，PMOS 和 NMOS 同时导通，形成 V_{dd} 到 GND 的瞬时通路。



核心影响因素:

翻转速率 与输入/输出 翻转速率 有关。输入斜率越慢, 导通时间 t_{sc} 越长。设计中通常控制短路功耗在总动态功耗的 10%~15%。
器件尺寸 I_{peak} 与 W/L 成正比。增加逻辑门驱动强度(增大尺寸)会直接导致短路功耗上升。

逻辑门的能量

能耗与功耗:

能耗	从电源取得的总能量
全摆幅	$E_{0 \rightarrow 1} = C_L V_{dd}^2$
周期	一个翻转周期 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$

开关活动性 动态功耗的核心统计学指标:

定义 开关活动性 $\alpha_{0 \rightarrow 1}$ (翻转概率) 指逻辑门在一个时钟周期内发生 $0 \rightarrow 1$ 翻转的概率。
计算公式 $\alpha_{0 \rightarrow 1} = p_0 \cdot p_1$, 其中 p_0, p_1 分别为输出为 0 和 1 的概率。
静态分布 对于 N 输入逻辑门, $\alpha_{0 \rightarrow 1} = \frac{N_0}{2^N} \cdot \frac{N_1}{2^N}$, 其中 N_0, N_1 为输出 0 和 1 的状态数。

● 等效电容: $C_{EFF} = \alpha_{0 \rightarrow 1} C_L$, 则动态功耗 $P = C_{EFF} V_{dd}^2 f_{0 \rightarrow 1}$

● 实例计算: 计算 $\alpha_{0 \rightarrow 1}$ (假设输入信号为 1 的概率均为 1/2):

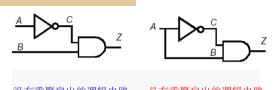
● 示例 1-2 输入 NOR: ● 示例 2-2 输入 XOR:

真值表	仅 $A = B = 0$ 时输出为 1
概率	$p_1 = 1/4, p_0 = 3/4$
翻转率	$\alpha_{0 \rightarrow 1} = 3/4 \times 1/4 = 3/16$

● 常用逻辑门翻转概率:

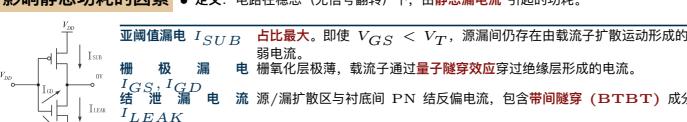
AND 门	输出为 1 的概率 $p_1 = P_A P_B$, 则 $\alpha_{0 \rightarrow 1} = (1 - P_A)(1 - P_B)$
OR 门	输出为 1 的概率 $p_1 = 1 - (1 - P_A)(1 - P_B)$, 则 $\alpha_{0 \rightarrow 1} = (1 - P_A)p_1$
XOR 门	输出为 1 的概率 $p_1 = P_A(1 - P_B) + P_B(1 - P_A)$, 则 $\alpha_{0 \rightarrow 1} = (1 - P_A)p_1$

信号间的相关性 当电路中存在重聚扇出结构时, 逻辑门输入端信号不再相互独立。



● 结论: 简单概率乘法不再适用, 需利用 条件概率 建模或使用 CAD 工具进行仿真分析。

影响静态功耗的因素 ● 定义: 电路在稳态(无信号翻转)下, 由 静态漏电流 引起的功耗。



体效应 ● 定义: 又称 偏置效应。当源极电位高于衬底电位($V_{SB} < V_T$)时, 浪耗尽层电荷增加, 导致开启晶体管所需的阈值电压 V_T 上升。

计算公式 $V'_T = V_T + \gamma(\sqrt{V_{SB}} + 2\phi_F) - \sqrt{2\phi_F}$ 即 V'_T 越大, 有效 V_T 越低, 漏电流越大。
参数说明 γ 为偏置效应系数, 与氧化层电容 C_{ox} 和衬底掺杂浓度 N_A 有关。
结论 在堆叠结构中, 由于 $V_x > 0$ 导致 $V_{SB} > 0$, 使 V'_T 增大, 从而有效减小漏电流。

DIBL 效应 ● 定义: 漏端感应势垒降低效应。当 V_{DS} 较高时, 漏端电场渗透至源端降低势垒高度, 导致电子易注入沟道, 从而降低阈值电压。

公式 $V'_{T0} = V_{T0} - \eta V_{DS}$ 即 V_{DS} 越大, 有效 V_T 越低, 漏电流越大。
堆叠关联 堆叠结构中上方管 V_{DS} 减小 ($V_{DD} \rightarrow V_{DD} - V_x$), 使 V_T 保持较高, 抑制漏电。
严重后果 若 V_{DS} 过大可能产生源漏穿通(Punch-through), 电流不再受栅压控制。

高阈值器件位置 阈值电压高的晶体管放在外层(远离输出端), 其它堆叠管的源端电位更高。

堆叠效应(降低静态功耗的手段) ● 定义: 当两个或多个晶体管串联(堆叠)且同时截止时, 其总漏电流显著小于单管截止时的漏电流。

● 物理模型: 在堆叠结构中, 中间节点 x 会因小漏电流充电达到稳态电压 $V_x > 0$ 。亚阈值电流公式:

$$I = I_{ds0} e^{\frac{V_{gs} - V_{th}}{nkT/q}} (1 - e^{\frac{-V_{ds}}{kT/q}})$$

负载电容 C_L 的影响:

负载较大 输出 V_{out} 变化慢, 管子漏源压差小, 短路电流 $I_{sd} \approx 0$ 。
负载较小 输出 V_{out} 变化快, 管子进入饱和区, 短路电流达到最大值 I_{MAX} 。

定量计算:

$$\text{积分公式 } V_{DD} \cdot \int_0^{t(V_{DD} - V_T)} I(t) dt \cdot f$$

$$\text{近似公式 } P_{sc} = \frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_T} I_{peak} t_{sc}$$

其中 I_{peak} 为峰值, t_{sc} 为有效持续时间。

核心物理机制:

负 V_{GS} 体效应 对于上管 M1, $V_{GS1} = 0 - V_x = -V_x$ 。由于亚阈值电流随 V_{GS} 呈指数下降, 负的栅源电压极大地抑制了漏电流。源极电位 V_x 升高导致 $V_{SB} > 0$ 。根据体效应, M1 的阈值电压 V_T 升高, 进一步减小漏电流。
DIBL 减弱 漏源电压 $V_{DS1} = V_{DD} - V_x$ 减小, 削弱了漏致势垒降低效应(DIBL), 使 V_T 相对保持在较高水平。

习题解析

课堂练习 ● 例题 1: 当逻辑门电容以外部负载电容为主时, 尺寸放大 2 倍以减小延时, 其平均功耗变为 2 倍, 一次翻转能耗变为 1 倍。

能耗分析

一次翻转能耗 $E = \frac{1}{2} C_{total} V_{DD}^2$ 。因 C_{load} 占据主导且保持不变, $C_{total} \approx C_{load}$, 故首次翻转做功总量不变。

功耗分析

平均功耗 $P \propto f \cdot I$ 。尺寸放大 2 倍使驱动电流 I 变为 2 倍, 单位时间内从电源汲取的能量(功率)随之变为 2 倍。

延时分析

传播延时 $t_p \propto \frac{C_{total} V_{DD}}{I}$ 。由于 C_{total} 近似不变而 I 翻倍, 延时 t_p 缩小为原来的 1/2。

PDP 验证 $PDP = P_{avg} \cdot t_p = (2P) \times (0.5t_p) = E$ 。功耗延时积(即能耗)在尺寸放大后保持一致。

● 例题 2:

已知 $C_{ext}/C_{g1} = 4$, 调节 V_{DD} 使总延时 $D \leq D(f=1, V_{DD_nom})$, 求 $f = 1.2$ 与 $f = 1.4$ 谁的最优能耗更低?

● 延时计算分析:

单级延时 $d = p + g \cdot h$, 反相器 $p = 1, g = 1$
第一级 负载 $4C_{g1}$, 输入 $C_{g1} \Rightarrow h_1 = f, d_1 = 1 + f$
第二级 负载 $4C_{g1}$, 输入 $fC_{g1} \Rightarrow h_2 = 4/f, d_2 = 1 + 4/f$

延时模型

总延时 $D = d_1 + d_2 = (1 + f) + (1 + 4/f) = 2 + f + 4/f$ (单位 t_p)

基准约束 $f = 1$ 时, $D_0 = 2 + 1 + 4 = 7t_p$ 。此为设计必须满足的延时上限

延时计算 $D(1.2) = 2 + 1.2 + 3.33 = 6.53t_p$; $D(1.4) = 2 + 1.4 + 2.86 = 6.26t_p$

● 电压缩放原理: 延时 $t_p \propto \frac{V_{DD}}{(V_{DD} - V_t)^{\alpha}}$, 降低 V_{DD} 会使电路变慢, 能耗 $E \propto V_{DD}^2$, 降低 V_{DD} 显著降低能耗。

● 优化策略: 若电路速度快于设计要求, 可通过降低 V_{DD} 牺牲速度冗余来换取能耗下降。

● 分析: 由于 $D(1.4) = 6.26$ 且 $D(1.2) = 6.53$, 两者均小于基准 $D_0 = 7$ 。 $f = 1.4$ 方案的速度冗余更大, 意味着其电源电压 V_{DD} 具有更大的下降空间。

● 结论: $f = 1.4$ 的最优能耗更低。根据 $E \propto V_{DD}^2$, 允许电压降幅越大, 最终能耗越小。

作业题

第四章 数字集成电路的鲁棒性

信号完整性 ● 定义: 信号在传播过程中保持原始形状的能力。本质是研究数字信号的模拟特性(即电压或电流随时间变化的波形物理退化)。

幅度 电压电平是否足够高(逻辑 1)或足够低(逻辑 0), 防止因衰减导致识别错误。信号边缘跳变是否在预定窗口内到达, 防止延迟或抖动导致时序违例。

● 判定标准: 信号必须以要求的时序和要求的电压幅度到达接收端。

● 工程目标: 研究电路在存在噪声的情况下如何保持正确的功能。

噪声模型 ● 数学模型: $V_{no} = f(V_{ni}) + g(V_{ngate})$ 。

输入噪声 前一级输出噪声成为当前级输入。
路噪 路噪包含电源噪声和耦合噪声(如串扰等)。
输出噪声 上述所有噪声在输出的总和。

● 信号再生: 为防止噪声在多级传输中积累淹没信号, 数字电路必须具备将受到的信号恢复至标准电平的能力。

信号再生 ● 信号再生性: 当第一级输入偏离额定电平时, 后面各级仍能恢复其正确值。

● 反相器链: 观察 $V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \dots$ 的瞬态响应:

输入 V_0 波形质量差, 边缘缓且电平有偏差。
中间 V_1 波形反相, 但仍存在跨变。

恢复 V_2 波形变得陡峭, 电平接近理想值。

● 再生性(Regenerative):

定义 当第一级输入偏离额定电平时, 后面各级仍能恢复其正确值。
本质 具备去噪与阈值判决能力, 将输出拉回标准 V_{DD} 或 GND 。

噪声容限

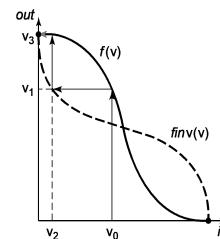
开关阈值与单级噪声容限 ● 物理意义: 若噪声使输入进入高增益过渡区, 输出将产生逻辑错误。 V_{IH} 需高于 V_M 一定程度, V_{IL} 需低于 V_M 一定程度。

● VTC 曲线与再生性:

再生性 过渡区陡峭 ($|Gain| > 1$), 输入偏差经 $f(v)$ 映射后收敛至稳态(Rail-to-Rail)。
不可再生 过渡区平缓, 输入偏差无法修正, 甚至因多次迭代发散或停留在中间态。

● 关键概念:

开关阈值 V_M $V_{in} = V_{out}$ 的交点。逻辑判断的中间分界点, 电路处于亚稳态。
斜率 = -1 声容容限的边界判定标准。界定逻辑稳态区(增益 < 1)与过渡区。
单级噪声容限 输入最大偏差不能超过 $(V_{OH} - V_M)$ 和 $(V_M - V_{OL})$ 。



第五章 互连线与互联技术

互连线模型

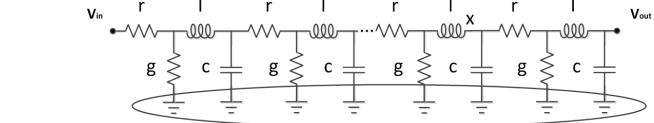
互连线模型 互连线的电气特性建模, 重点在于从物理结构到电路模型的抽象, 以及对寄生电容特别是对地电容的精确计算。

● 分布参数模型: 基于物理结构抽象出的电路模型。

寄生电阻 R 代表导线自身电阻。由于有限电导率和横截面积, 电流流过时产生压降和功耗。
寄生电感 L 代表导线自感, 高频下变化的电流产生磁场并感应出电动势, 影响信号完整性。
寄生电容 C 分为两类:
1. 对地/衬底电容: 导线与底部半导体衬底(GND)间形成的电容。
2. 线间电容: 相邻导线间因电位差形成的耦合电容(Coupling)。

互连线的寄生效应

下图展示了互连线在物理上最完整的电气模型, 称为 传输线模型。



寄生电容 寄生电容主要包括对地电容和线间电容:

● 对地电容: 单根导线与下方衬底(交流地)间的电容。
平行板模型 假设仅存在垂直均匀电场。 $C_{pp} = (\epsilon_d / t_d) W L$
其中 L, W 为长宽, t_d 为绝缘层厚度。
边缘电容 考虑导线厚度 H , 墙壁发出的边缘场形成的附加电容 C_{fringe} 。
总对地电容 $C_{wire} = C_{pp} + C_{fringe}$ 。

● 几何比例影响: 大 W/H 时 C_{pp} 主导; 小 W/H (窄高导线) 时边缘场效应显著, C_{fringe} 占主要部分。

● “三明治”结构模型: 关注 Layer n 的中间导线(受害线)及其周围物理环境。

垂直环境 Layer n+1 (上层金属板/布线层) 与 Layer n-1 (下层金属板/衬底)。
水平环境 Layer n 与同层左右两侧的相邻导线。

● 电容分量分解 受害导线(Victim Wire)的寄生电容可分解为:
底板电容 C_{bot} 导线底面与下层间的平行板电容, 主要由介质厚度 t_1 决定。
顶板电容 C_{top} 导线顶面与上层间的平行板电容, 主要由介质厚度 t_2 决定。
侧壁电容 C_{adj} 与同层左右相邻导线间的耦合电容, 由间距 S 和导线厚度 h 决定。

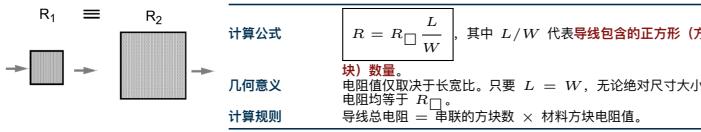
● 总对地电容计算: 前提: 若周围导线均连接至固定电位(即视为交流地)。

计算公式 $C_{total} = C_{top} + C_{bot} + 2 \times C_{adj}$

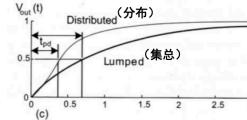
设计意义 定义了该节点驱动的总容性负载, 对计算互连线延时和功耗至关重要。

寄生电阻 ● 物理电阻公式: 基于电阻定律: $R = \rho L / A = \rho \cdot L / W \cdot V$ 。其中 ρ 为电阻率, H 为导线厚度, W 为宽度, L 为长度。

● 方块电阻: 在集成电路中, 厚度 H 由工艺固定。定义 $R_{\square} = \rho / H$ (单位: Ω/\square)。



传播延时 t_p (50%): 集总: $t_p = 0.69RC$
分布: $t_p \approx 0.38RC$
时间常数 τ (63%): 集总: $\tau = 1RC$
分布: $\tau = 0.5RC$
上升时间 t_r (10% - 90%): 集总: $t_r = 2.2RC$
分布: $t_r = 0.9RC$



● **典型材料特性:** 反映了不同层导电性能的巨大差异:

金属 (Al, Cu) 0.05Ω/□. 极低, 适合长距离信号传输。
多晶硅 (Poly) 10 ~ 15Ω/□. 较高, 常用于短距离连接或栅极。
扩散区 (Diff) 20 ~ 30Ω/□. 最高, 主要存在于有源区。

接触电阻 (了解即可) ● **定义:** 层与层之间的电气连接 (接触孔和通孔) 引入的额外电阻。

物理结构: 多层金属或金属与半导体体间的垂直连接。
设计原则: 应尽可能减少接触孔和通孔的数量, 以降低压降和信号延迟。

● **尺寸与电阻关系:**

基本规律: 接触电阻与接触面积成反比, 理论上增大尺寸可减小电阻。
物理局限: 受限于**电流集聚效应**, 单纯增大单个孔径效率较低。

● **电流集聚效应:**

现象描述: 电流从高导电率层流入高电阻率层时, 流线分布不均匀。
分布特征: 电流集中在接触孔的**周边**, 中心区域电流密度极小。
后果: 中心面积未被充分利用, 大尺寸接触孔的电阻率很低。

● **工程解决方案:**

核心结论: 采用多个小尺寸接触孔并联以减小接触电阻。
原理解析: 利用并联电阻公式 $R_{total} = R/n$ 降低总阻值, 并通过增加总周边长度减轻集聚效应, 使电流分布更均匀。

寄生电感 ● **计算原理:** 利用电磁场理论中电感与电容的内在物理联系, 通过已知的电容参数来推导电感参数。

L-C 耦合关系: 对于处于均匀介质中的传输线, 单位长度电容 c 与电感 l 满足:

$cl = \varepsilon\mu$
 ε 为介电常数, μ 为磁导率。

在均匀介质中, **一旦计算出寄生电容 c , 即可直接推导出寄生电感 l** , 无需进行复杂的磁场分布计算。

● **电磁波传播速度:** 信号 (电磁波) 在互连线中的传播速度 v 由 l 和 c 决定:

基础公式: $v = 1/\sqrt{lc}$

介质参数表示: $v = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$

相对参数表示: $v = c_0/\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}$, 其中 c_0 为真光速, ε_r 为相对介电常数, μ_r 为相对磁导率。

互连线中的信号传播速度主要受**周围绝缘介质的材料特性 (ε_r)** 限制。

● **忽略电感的前提:** 集成电路芯片内部导线寄生电感通常极小, 可忽略。

物理机制: 在低速或高阻抗电路中, R 和 C 效应占主导, 感抗 $j\omega L$ 远小于电阻 R 。
建模简化: 通常将导线建模为 **RC 电路而不是 RLC 电路**。

● **考虑电感的必要条件:** 必须引入电感建模的两个关键条件:

低电阻: 使用铜 (Cu) 等低阻阻金属且导线截面较大, 使电阻 R 降低, 感抗占比提升。
高开关频率: 感抗 $X_L = 2\pi fL$ 与频率成正比。高频频下即使 L 很小, 感抗也会显著影响性能。

● **寄生电感引发的电路现象:** 高频电路中由电感主导的负面效应:

振荡: RLC 电路二阶跃响应特征。若阻尼不足, 电压会在稳定值附近谐振摆动。

过冲: 伴随振荡产生。电压瞬时超过 V_{DD} 或低于 GND , 可能导致击穿或误触发。

信号反射: 高频下视为传输线。若特性阻抗 $Z_0 = \sqrt{L/C}$ 与端点不匹配, 信号在终端反射。

线间互感: 相邻导线间的磁场耦合产生感应电动势 (互感), 是产生串扰的磁性分量 (对应容性串扰)。

● **Elmore 延时:** 工程近似方法。通用公式: $\tau_{DN} = \sum_{i=1}^N C_i (\sum_{j=1}^i R_j)$ 。即各节点电容与其到端口路径电阻之积的加权和。

● **均匀线推导:** 将 L 分为 N 段, 每段 $r \Delta L, c \Delta L$ 。取 $N \rightarrow \infty$ 极限, 求和系数 $\frac{N(N+1)}{2N^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

集总模型 ● **适用条件:** 导线很短, 其自身寄生电阻 r 远小于驱动门的输出电阻, 且高根电感 l 在高频下的阻抗可忽略。

分布模型 ● **适用条件:** 导线较长, 电阻效应显著, 信号沿线存在电压梯度, 不能视为等电位体。

物理特性: 导线可被视为一个等电位体 (理想导线)。
延时计算: $\tau = RC = rcl^2$ 。

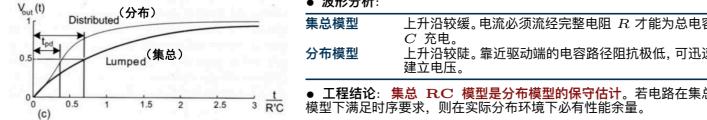
参数说明: r, c : 单位长度的电阻和电容。
模型简化: 整根导线被简化为一个**单一的集总电容**, 作为驱动门的负载负载。

● **曲线分析:** 图中曲线代表导线不同位置 x 的电压响应:

$x = L/10$ 响应极快, 上升沿陡峭, 波形接近输入阶跃信号。
 $x = L$ 响应最慢, 上升沿变得非常平缓, 延迟最大。

● **物理特性分析:**
扩散效应: 由于分布电容和电容的存在, 信号能量被“平摊”。高频分量 (对应陡峭上升沿) 被减低分量最快。
信号延迟: 信号到达末端不仅幅值上升缓慢, 且存在明显的传输延时。

阶跃响应对比 (集总 vs 分布): 量化集总模型和分布模型在响应速度上的差异:



动态逻辑的速度和功耗

第七章 时序逻辑

双稳态原理

锁存器

主从边沿触发寄存器

时钟偏差和时钟抖动

第八章 加法器

二进制加法器

进位选择加法器

进位旁路加法器

超前进位加法器

第九章 乘法器

二进制乘法器 (有、无符号)

部分即产生 (部分积压缩、Booth 编码)

部分累加

逐位进位阵列乘法器

进位保留乘法器

最终相加

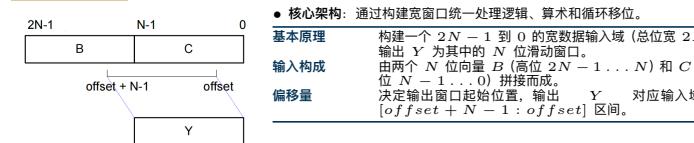
第十章 移位器

移位器设计

● 移位种类: 三种常见的数字逻辑移位操作:

逻辑移位: 空位统一填充 **0**, 常用于无符号数乘除 (左移 $\times 2$, 右移 $\div 2$) 或位操作。
算术移位: 针对带符号数。右移需进行**符号扩展** (MSB 保持不变, 空位补符号位); 左移通常低位补 **0**, 需注意溢出。
循环移位: 数据视为环形, 移出的位重新填入另一端空位, 不丢失信息。

● **漏斗型移位器**: 只介绍了移位的实现方法, 并未介绍其具体电路结构。



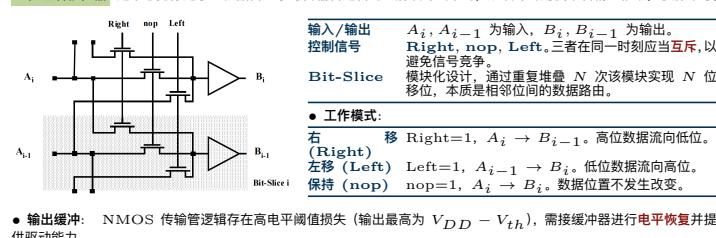
● **操作映射表:** 设定原始 N 位数据为 A , 移位量为 k :

Table 10.10 Funnel shifter operation			
Shift Type	B	C	Offset
Logical Right	0...0	$A_{N-1}...A_0$	k
Logical Left	$A_{N-1}...A_0$	0...0	$N-k$
Arithmetic Right	$A_{N-1}...A_{k-1}$	$A_{N-1}...A_0$	k
Arithmetic Left	$A_{N-1}...A_0$	0	$N-k$
Rotate Right	$A_{N-1}...A_0$	$A_{N-1}...A_0$	k
Rotate Left	$A_{N-1}...A_0$	$A_{N-1}...A_0$	$N-k$

逻辑右移: $B = 0, C = A$, Offset = k , 高位滑入 B 区的 0, 实现高位补 0。
逻辑左移: $B = A, C = 0$, Offset = $-N - k$, 从高位“回退”截取, 低位引入 C 中的 0_s 。
算术右移: $B = A_{N-1}...A_{k-1}$ (符号位), $C = A$, Offset = k , 高位填充符号位。
算术左移: $B = A, C = 0$, Offset = $N - k$, 通路同逻辑左移, 区别在于溢出判断。
循环右移: $B = A, C = A$, Offset = k , $[A, A]$ 结构使输出的低位在高位出现。
循环左移: $B = A, C = A$, Offset = $N - k$, 利用偏移量实现反向的循环移动。

● **核心逻辑:** 漏斗型移位器本质是“截取”结构, 通过调整 B, C 内容与 $N - k$ 偏移量将左移转化为右移截取。

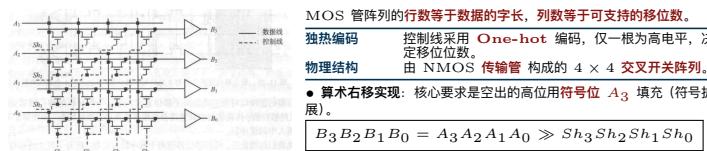
一位左右移位器: 这个感觉像是学生根据自己学习传输管逻辑的理解设计出来的, 从设计的角度来看稍显稚嫩, 了解即可。



● **工作模式:**
右移: Right = 1, $A_i \rightarrow B_{i-1}$. 高位数据流向低位。
左移 (Left): Left = 1, $A_{i-1} \rightarrow B_i$. 低位数据流向高位。
保持 (nop): nopl = 1, $A_i \rightarrow B_i$. 数据位置不发生改变。

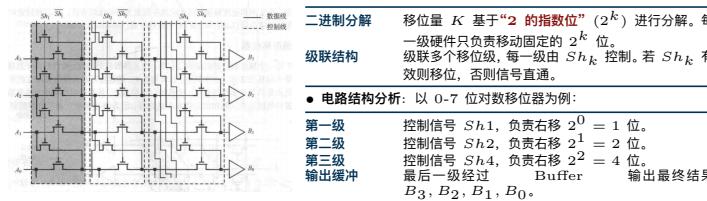
● **输出缓冲:** NMOS 传输管逻辑存在高电平阈值损失 (输出最高为 $V_{DD} - V_{th}$), 需接缓冲器进行**电平恢复**并提供驱动能力。

桶型移位器 • 系统架构: 定义输入 $A = (A_3 \dots A_0)$, 输出 $B = (B_3 \dots B_0)$, 控制信号 $Sh = (Sh_0 \dots Sh_3)$ 。信号最多通过一个传输门, 理论上移位延时不依赖于移位器的大小和移位位数。



Sh_0 (不移位)	$A_3 \rightarrow B_3, A_2 \rightarrow B_2, A_1 \rightarrow B_1, A_0 \rightarrow B_0$
Sh_1 (右移 1 位)	$A_3 \rightarrow B_2, A_2 \rightarrow B_1, A_1 \rightarrow B_0$, 且 $B_3 = A_3$
Sh_2 (右移 2 位)	$A_3 \rightarrow B_1, A_2 \rightarrow B_0$, 且 $B_3 = B_2 = A_3$
Sh_3 (右移 3 位)	$A_3 \rightarrow B_0$, 且 $B_3 = B_2 = B_1 = A_3$

对数移位器 • 核心设计理念: 采用分级控制, 将总移位值分解为二进制权重的组合。



• 移位范围: 对于 N 位数据, 通常级联 $\log_2 N$ 级。图中三级结构支持最大 $1 + 2 + 4 = 7$ 位的移位量, 适用于大范围移位场景。

对数移位器原理与特性 • 单元逻辑: 本质为并行的 2 选 1 多路复用器 (2-to-1 MUX)。

结构	每一级节点由两个 NMOS 传输管组成: 一个负责直通路径, 一个负责移位路径。
控制逻辑	每一级根据二进制控制位决定是“直通”还是“跳跃” 2^k 位。

• 性能分析与设计权衡:

速度特性	延迟与移位宽度 M 呈对数关系, 即具有 $\log_2 M$ 级延迟。
RC 延时	信号必须穿过每一级传输管, 串联电阻导致 RC 延时随级数累积。
优化手段	在级与级之间插入 中间缓冲器 (Buffer), 以打断长 RC 链并恢复信号驱动能力。
控制编码	无需译码器。控制信号直接对应二进制值 (如移位 3 位即 $Sh_1 = 1, Sh_2 = 1, Sh_4 = 0$)。

• 适用场景对比:

桶型移位器	适用于 小位宽。仅一级传输管延迟, 速度极快, 但面积代价随位宽增加迅速上升。
对数移位器	适用于 大位宽 (如 64 位以上)。结构易于参数化和 EDA 自动生成, 面积效率更高。

习题解析

作业题 • 作业 6-2: 画出一个支持循环右移的 4-bit 桶型移位器的电路结构图

这里牢王应该是让这个移位器只支持循环移位, 桶型移位器就像 Mask ROM 一样, 设好就改不了了。

第十一章 MOS 存储器

MOS 存储器分类

存储器结构

存储体

地址译码器

读写控制及输入输出电路

Mask ROM

SRAM

DRAM

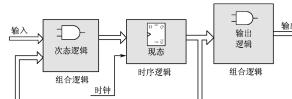
第十二章 Verilog 硬件设计

组合逻辑

时序逻辑

状态机 • 基本组成: 状态机由三个核心模块构成:

次态逻辑	组合逻辑模块。负责根据“输入”和“现态”计算出下一个时钟周期应该跳转到的“次态”。
时序逻辑	存储模块 (通常由 DFF 构成)。负责存储“现态”, 在时钟边沿到来时, 将“次态”更新为新的“现态”。
输出逻辑	组合逻辑模块。负责产生系统的最终“输出”。



• 摩尔型 (Moore) 状态机: 输出仅取决于现态。

信号流向 输入信号与反馈的“现态”共同决定“次态”。“时序逻辑”在时钟驱动下更新“现态”。输出逻辑的输入仅来自于寄存器的输出 Q 端 (即现态)。

核心特征 时序逻辑与时序逻辑部分与 Moore 型基本一致。

同步特性 输出严格同步于状态变化。输入信号的改变必须先触发状态翻转, 才能传递至输出。

工程意义 输出通常比输入滞后一个周期, 但具有良好抗毛刺 (Glitch) 能力。



• 米利型 (Mealy) 状态机: 输出由现态与输入共同决定。

信号流向 次态逻辑与时序逻辑部分与 Moore 型基本一致。

关键特征 输出逻辑模块同时接收来自寄存器的“现态”与直接来自外部的“输入”信号。

响应特性 输出可对输入变化做出异步响应。在同一时钟周期内, 输入改变输出即可随之改变, 无需等待时钟边沿。

工程对比 实现相同功能时状态数通常更少, 响应速度更快; 但输入端的噪声或毛刺容易直接传递至输出端。

状态机设计描述方式 • 核心概念: 根据现态 (CS)、次态 (NS) 和输出逻辑 (OL) 在 always 块中的分配, 分为三种经典描述方式:

• 1. 三段式 (Three-process): 将三个逻辑环节完全解耦, 与硬件框图一一对应。

现态 (CS)	时序逻辑 always 块, 由时钟驱动更新状态寄存器。
次态 (NS)	组合逻辑 always 块, 根据输入和 CS 计算 NS。
输出逻辑 (OL)	独立组合逻辑 always 块, 描述输出信号。 优点 结构最清晰, 可读性最高, 利于综合工具进行时序分析和优化。

• 2. 两段式 (Two-process): 将逻辑环节进行合并, 是工业界常用的写法。

策略一: (CS+NS)	+ 第一个过程块描述现态更新与次态计算; 第二个描述输出。
策略二: (CS)	+ 第一个过程块描述寄存器更新; 第二个合并次态与输出逻辑。

特性 明确分离了时序逻辑与组合逻辑, 但需注意复杂 OL 可能导致关键路径过长。

• 3. 一段式 (Single-process): 将 CS, NS, OL 全部放入同一个时序 always 块中。

实现方式	通常基于时钟边沿触发, 代码量最少, 结构简洁。
输出特性	输出信号被综合为寄存器输出 (Registered Output), 天然无毛刺。

局限性 输出信号会比状态变化滞后一个时钟周期; 复杂 Mealy 机描述臃肿。

三段式状态机 这里放一个基于三段式描述的有限状态机 (FSM) 设计实例, 具体功能为“101 序列检测器”。

• 状态转移图分析: 该设计为 Moore 型状态机, 输出 z 仅取决于当前状态 (节点内标记为 S_n/z)。

S0/0	初始状态 (Idle), 表示未检测到有效序列。
S1/0	检测到了“1”, 即序列的第一位。
S2/0	检测到了“10”, 即序列的前两位。
S3/1	检测到了“101”, 序列匹配成功, 输出 $z = 1$ 。

• 转移逻辑 (重叠检测):

从 S0	输入 1 → S1; 输入 0 → S0。
从 S1	输入 0 → S2; 输入 1 → S1 (最新的“1”可作为新序列开头)。
从 S2	输入 1 → S3; 输入 0 → S0 (序列中断, 需重新检测)。
从 S3	输入 1 → S1; 输入 0 → S2 (最后的“1”或“10”作为下一流程前缀)。

第十二章 Verilog 硬件设计

组合逻辑

时序逻辑

状态机 • 基本组成: 状态机由三个核心模块构成:

次态逻辑	组合逻辑模块。负责根据“输入”和“现态”计算出下一个时钟周期应该跳转到的“次态”。
时序逻辑	存储模块 (通常由 DFF 构成)。负责存储“现态”, 在时钟边沿到来时, 将“次态”更新为新的“现态”。
输出逻辑	组合逻辑模块。负责产生系统的最终“输出”。